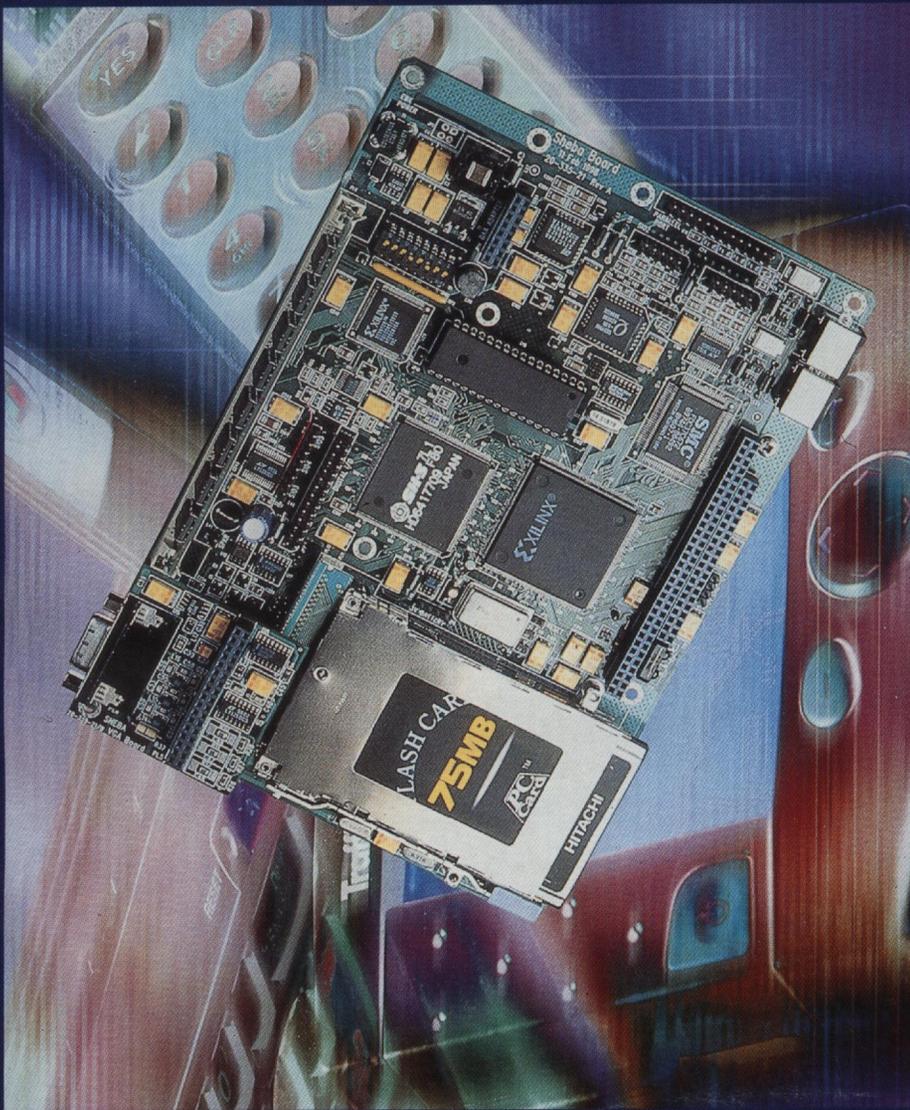




DOSSIER : La CEM dans les circuits intégrés



ISSN 1265-6534

REPÈRES : Les techniques spatiales dans la gestion des risques

INVITÉ

P. 6

● Eclairage : état de l'art
et évolution



INDUSTRIE ET MARCHÉS

P. 12

● L'Électronique
automobile rapproche
les deux industries



● La cogénération
entre à l'hôpital

● La maison du futur

RÉGIONS

P. 17

● Nouvelle unité de
production pour
STMicroelectronics

NORMES

P. 23

● Assemblée générale
de l'UTE

Sommaire

REE
REVUE DE
L'ELECTRICITE
ET DE
L'ELECTRONIQUE



N°7/2000 - Juillet

Editorial <i>par C. Boudenot</i>	1
Calendrier	4
Invité	6
Industrie et marchés	12
Régions	17
Formation, Recherche, Emploi	18
Normes et qualité	20
Revue de presse	22
Publications	23
Produits nouveaux	25
Partenaires	28
Dossier	
La CEM dans les circuits intégrés	30
Résumés/Abstracts	64
Repères	
Les techniques spatiales dans la gestion des risques	67
En direct avec la SEE	86
Service lecteurs	87

En couverture : Hitachi, EdF, Clarion

DOSSIER

La CEM dans les circuits intégrés

Les évolutions technologiques observées (fréquence, intégration, ...) au niveau des circuits intégrés entraînent des contraintes en matière de compatibilité électromagnétique qui s'avèrent d'autant plus importantes que le nombre de composants mis en œuvre augmente. Un point sur les techniques les plus récentes et sur les travaux normatifs s'impose.

Présentation <i>par J.-P. Catani</i>	30
Avancement des travaux de normalisation IEC47A/WG9 : méthodes de mesures CEM sur circuits intégrés <i>par C. Marot</i>	33
Méthode d'intégration des contraintes CEM dans la conception des circuits intégrés logiques à haute densité <i>par J.-L. Levant, M. Ramdani</i>	39
Vers un modèle CEM des circuits intégrés <i>par M. Lubineau, E. Sicard, C. Huet, P. Sant-Anna, J.C. Pourtau, L. Bessettes, P. Mounier, J. Logan, A. Ottenheimer, C. Marot</i>	44
Une méthode cohérente pour la prédiction des perturbations CEM de composants numériques : étude du courant de commutation <i>par F. Dubreuil, J.M. Dienot</i>	50
Comportement des composants logiques soumis à l'accumulation de perturbations induites par diaphonie interne et par des champs EM extérieurs <i>par A. Benbassou, M. Rifi, J. Baudet, B. Demoulin</i>	55
Simulation de l'émission électromagnétique des composants avec le logiciel EMC2000 <i>par A. Soubeyran, J.-P. Estienne, J. G. Ferrante, E. Sicard</i>	59